

國立交通大學

機械工程研究所

碩士論文

以紫外光固化膠在晶圓級低溫封裝之研究

A Low Temperature Wafer-Level Hermetic Package

Using UV Curable Adhesive



研究生：梁志豪

指導教授：徐文祥博士

鄭裕庭博士

中華民國 九十三年 六月